

Prof. Jürgen Becker

becker@kit.edu

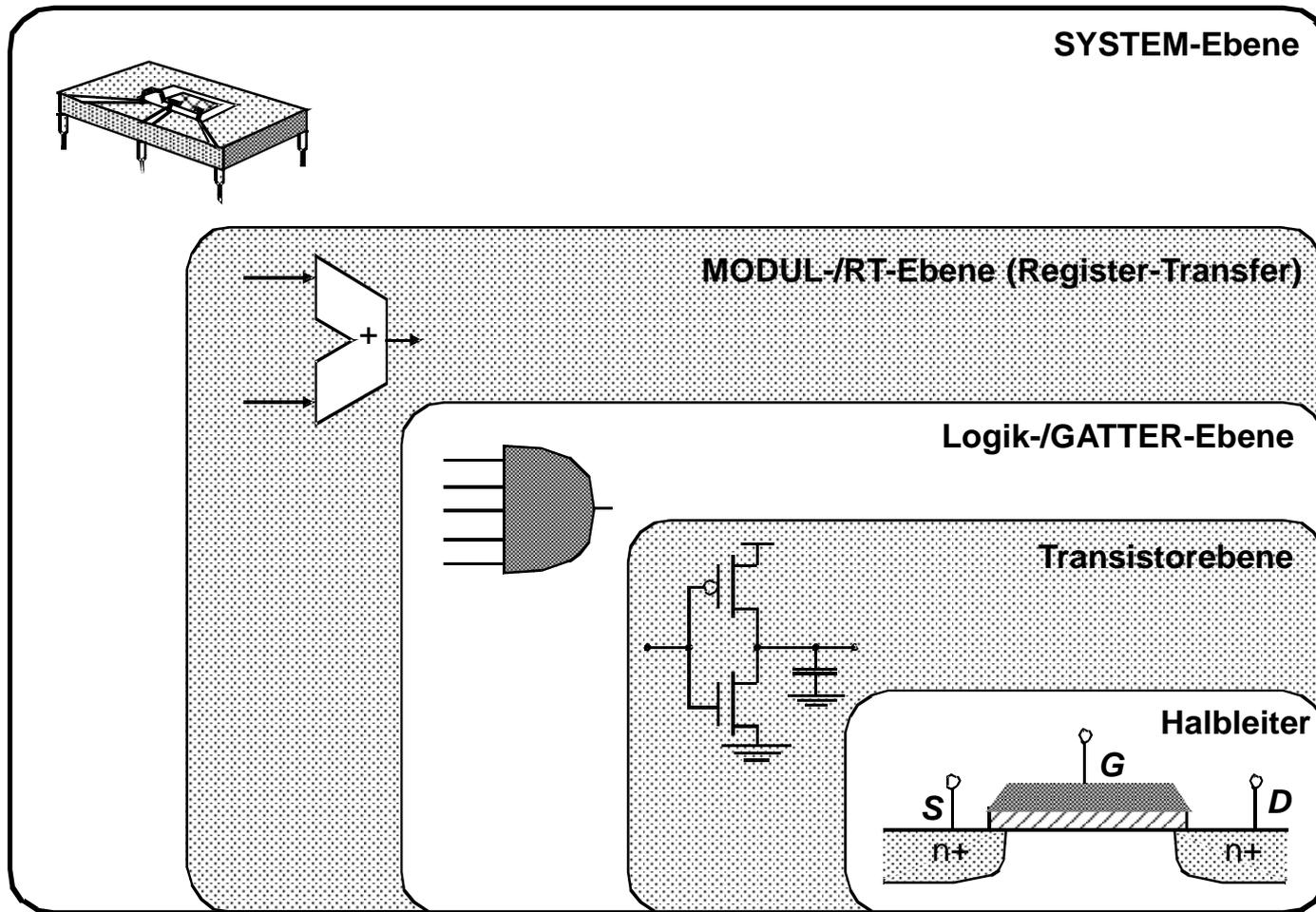
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

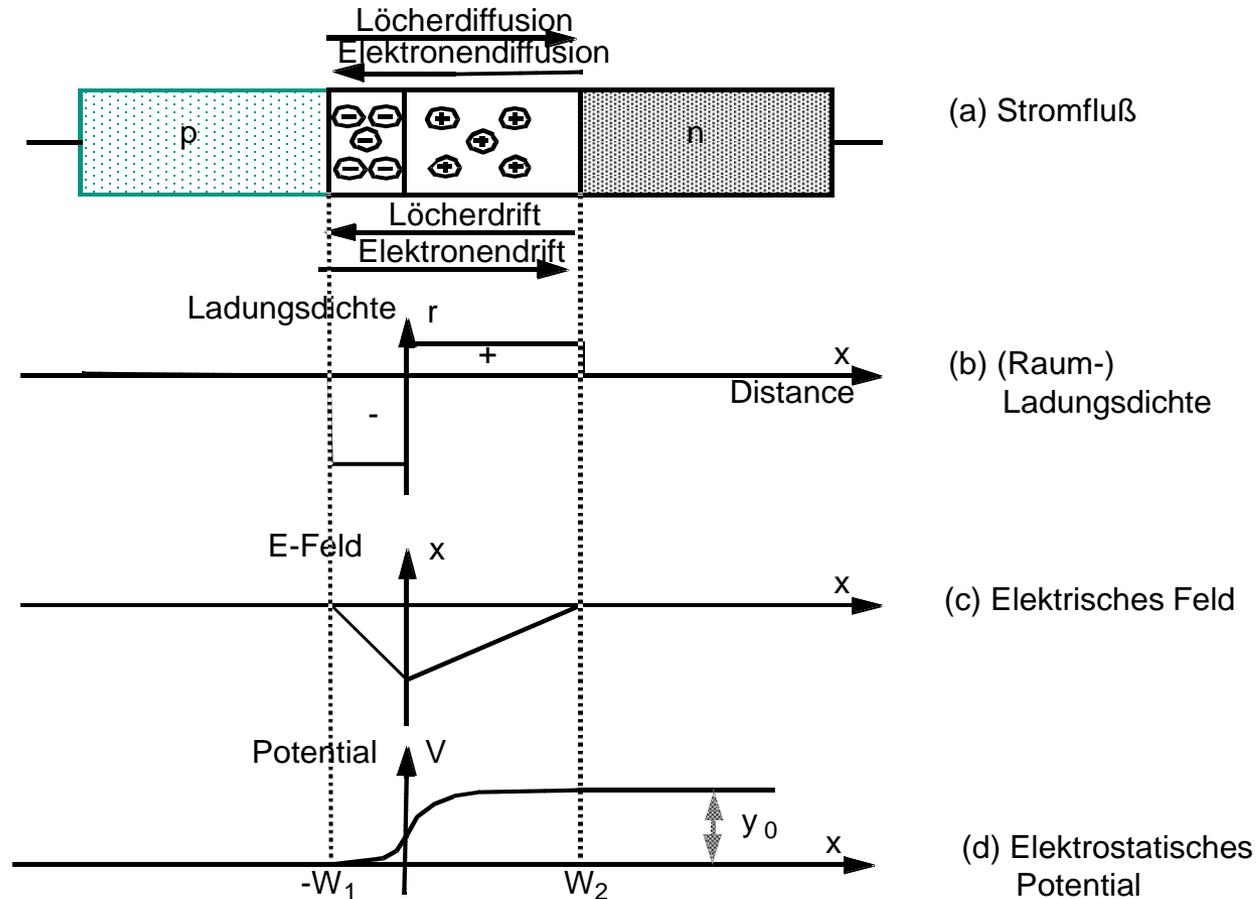
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)

Digitaltechnik

Einführung in CMOS-Technologie

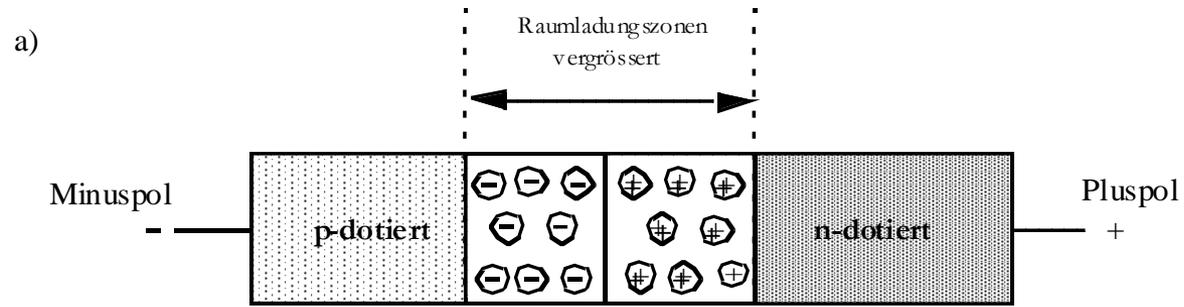
Entwurfsraum - Abstraktionsebenen



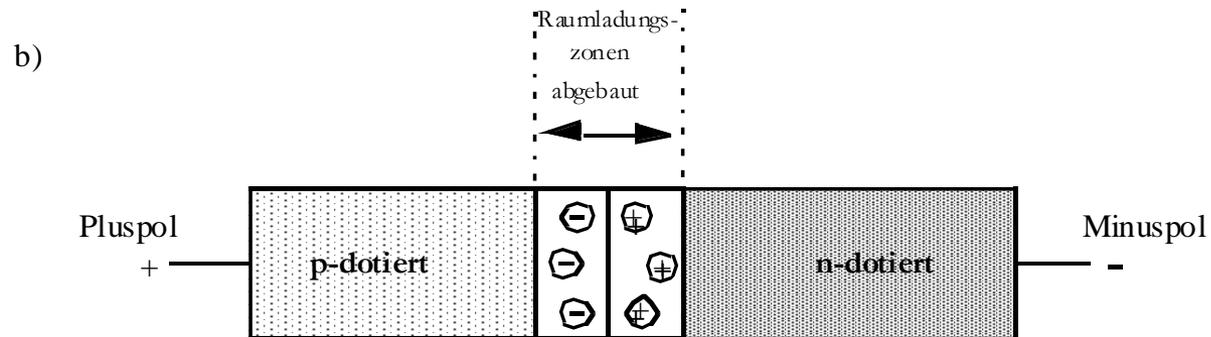


- **Diffusion:** Sowohl Elektronen als auch Löcher wandern in die p- bzw. n-Gebiete
- **Drift:** durch das Wandern der Ladungen entsteht ein Elektrisches Feld welches der Diffusion entgegenwirkt -> **Gleichgewicht** zwischen **Diffusion** und **Drift** entsteht

Sperrschicht- polung

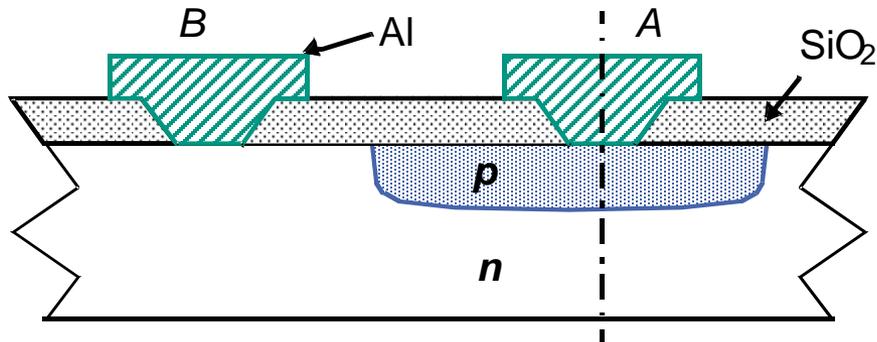


Durchlass- polung



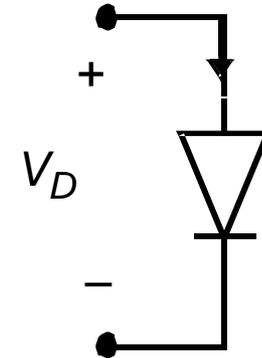
- a) **Sperrschichtpolung:** negativer Pol ans p-Gebiet, positiver Pol ans n-Gebiet
 → Raumladungszonen werden vergrößert
- b) **Durchlasspolung:** positiver Pol ans p-Gebiet, negativer Pol ans n-Gebiet
 → Raumladungszonen werden verkleinert
 → Ladungsträgerbewegung über die Grenzschicht

Aufbau einer Diode

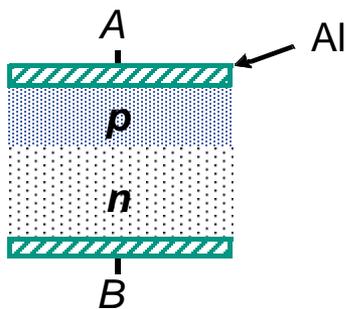


Querschnitt eines pn -Kontaktes in einem IC-Prozess

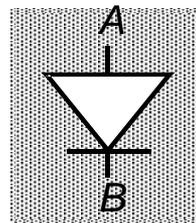
Ideales Diodenmodell



$$I_D = I_S (e^{V_D / T} - 1)$$



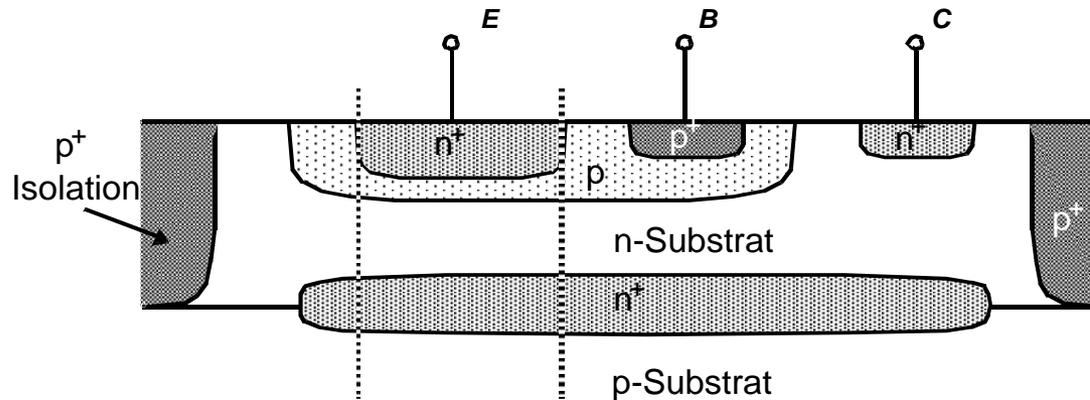
Eindimensionale Darstellung



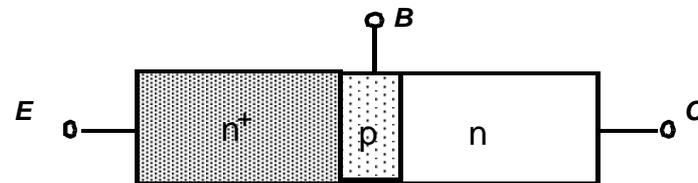
Diodensymbol

- **Diode** ermöglicht nur einen Stromfluss von p nach n , d.h. von Anschluss A nach B
- Die Gleichung I_D beschreibt das **Strom-/Spannungsverhalten** der Diode in Abhängigkeit von V_D

Aufbau eines Bipolar-Transistor



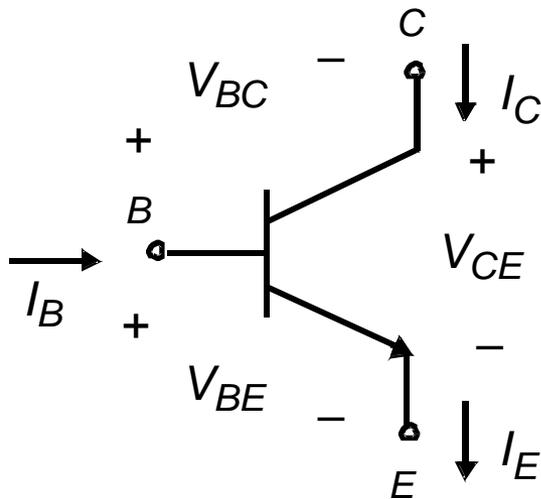
(a) Querschnittsdarstellung.



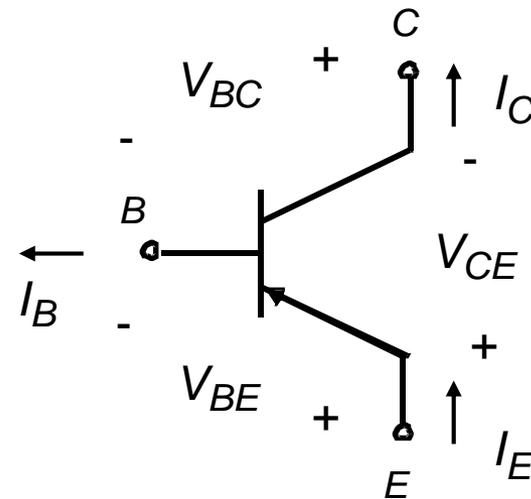
(b) Idealisierte Darstellung.

- **Bipolar-Transistoren** werden oft in Anschaltungen eingesetzt, z.B. Hifi-Verstärker
- Anordnung von **3 dotierten Gebieten**
 - > Folge **pn** oder **n**pn, wobei die mittlere Schicht sehr dünn ausgelegt wird
- Im Gegensatz zu MOS-Transistoren sind beim **Bipolar-Transistor** sowohl *Majoritäts-* als auch *Minoritätsladungsträger* beim Stromfluss beteiligt

Schaltsymbole und Vorzeichen-Konventionen:

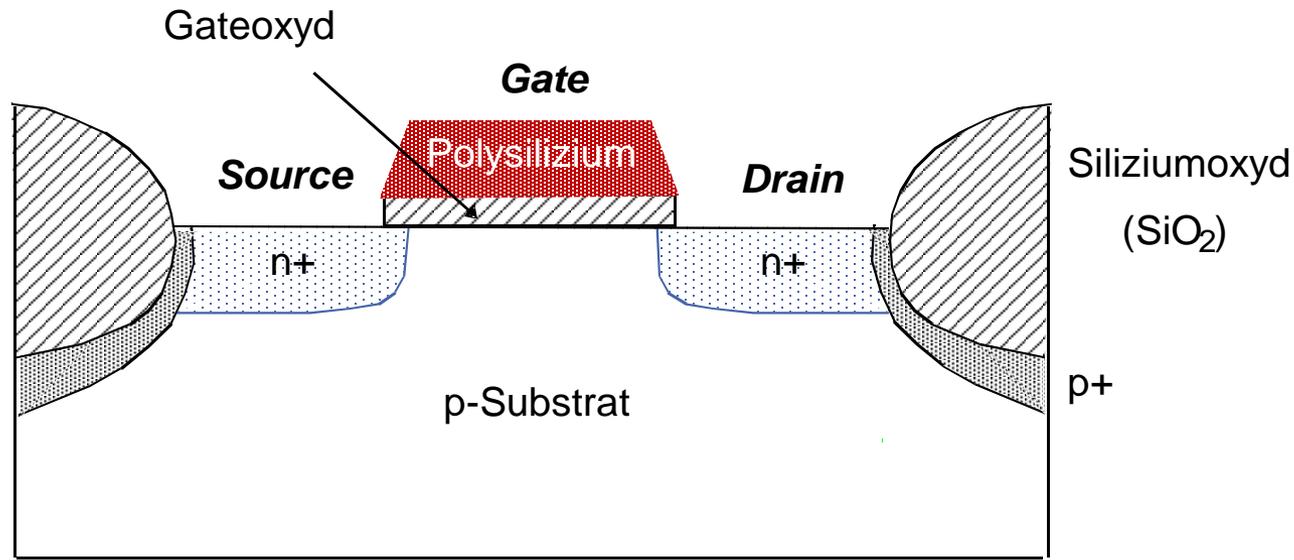


(a) *n*pn



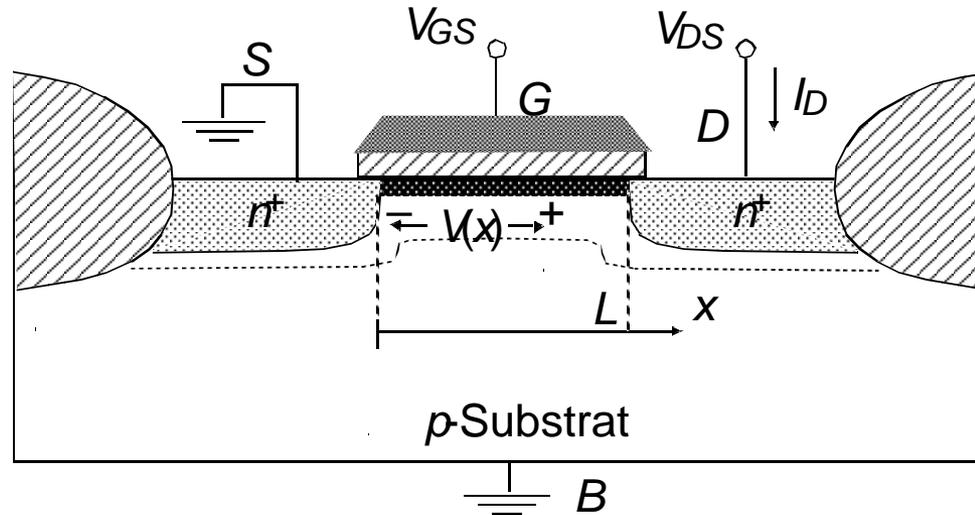
(b) *p*np

Querschnitt eines NMOS-Transistors:



- **MOS-FETs** werden meist in **Digitalschaltungen** eingesetzt
- Der **Strom** durch den **MOS-FET** fließt in **lateraler Richtung**
- Am Stromfluss sind ausschließlich Majoritätsladungsträger beteiligt
- Das **Gate** dient als Schalter -> aktiviert den **Kanal** zwischen **Source** und **Drain**
-> angelegte positive Spannung: zieht Elektronen an und verdrängt Löcher

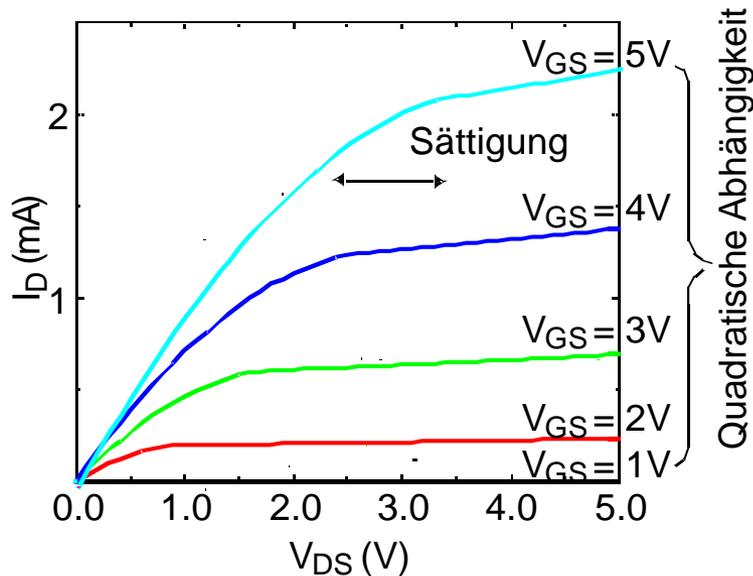
Strom-Spannungszusammenhang -> Durchlassspannung



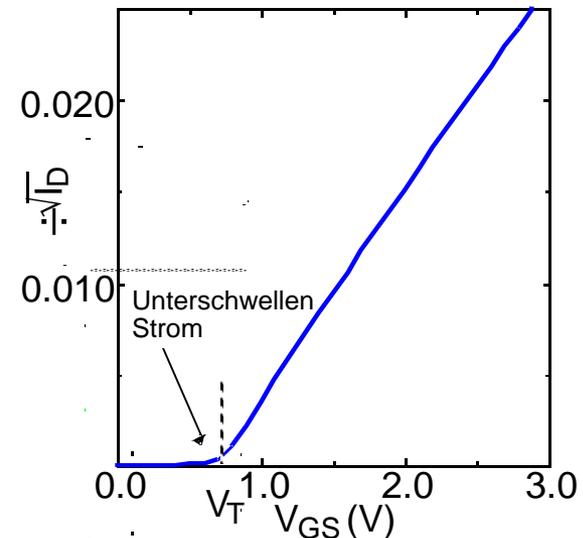
- **Transistor ist gesperrt:** d.h. $V_{GS} < V_{th}$, somit kann zwischen **Source** und **Drain** der **Strom I_D** **nicht** fließen
- **Transistor ist geöffnet:** d.h. $V_{GS} > V_{th}$, zwischen **Source** und **Drain** Gebieten bildet sich eine negative Ladungszone
→ **Stromfluss** zwischen **Source** und **Drain** ermöglicht

I-V Zusammenhang

(a) I_D als Funktion von V_{DS}

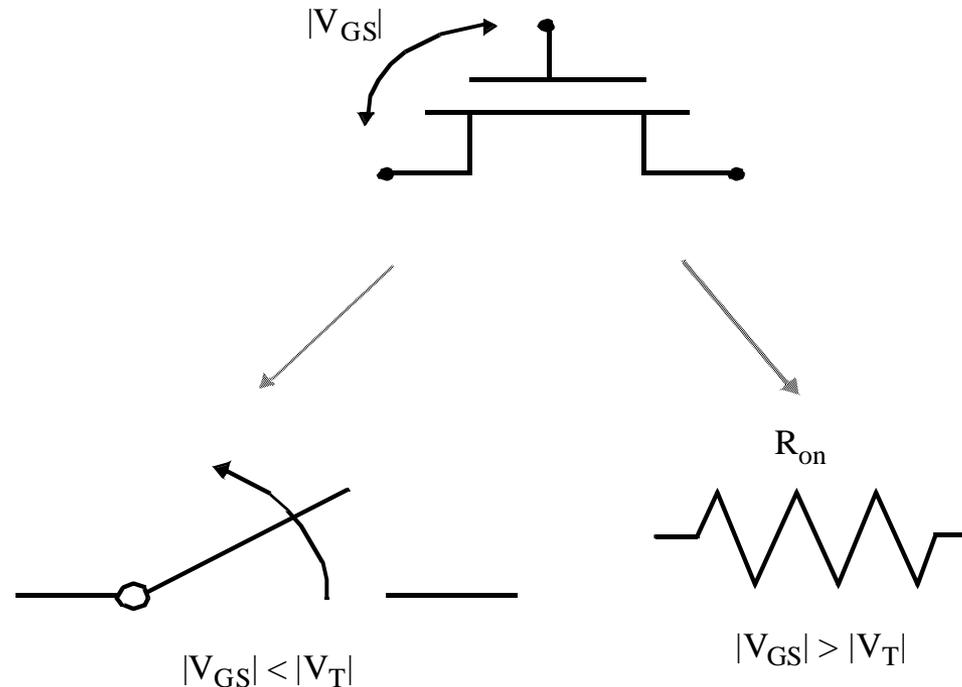


(b) $\sqrt{I_D}$ als eine Funktion von V_{GS}
(für $V_{DS} = 5V$)



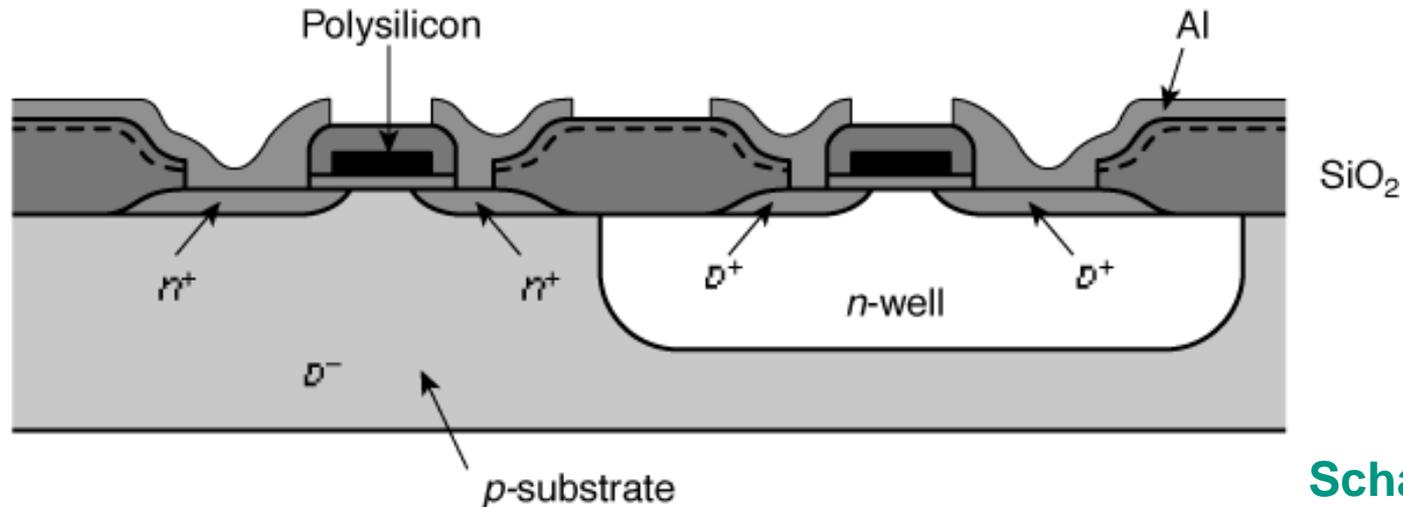
- Damit der Stromfluss I_D zustande kommt, muss die Ansteuerspannung V_{GS} den Wert V_T überschreiten (rechtes Diagramm)
- Ist die Ansteuerspannung V_{GS} größer V_T und konstant:
→ Strom I_D ist nur noch von V_{DS} abhängig (linkes Diagramm)

Schaltmodell:



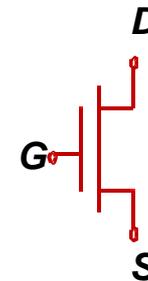
- Im **nichtleitenden Zustand**, d.h. $|V_{GS}| < |V_T|$ gilt: MOS-Transistor wird zu einem geöffneten Schalter \rightarrow Widerstand mit sehr hoher Impedanz, der Stromfluss behindert
- Im **leitenden Zustand**, d.h. $|V_{GS}| > |V_T|$ gilt: MOS-Transistor wird zu einem Widerstand mit einer sehr geringen Impedanz, der Stromfluss verstärkt (geschlossener Schalter)

Querschnitt der CMOS-Materialschichten (Complementary MOS)

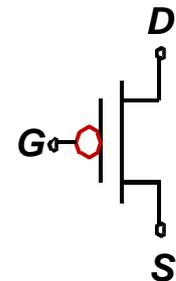


Schaltsymbole

- Man unterscheidet **zwei grundsätzliche MOS-Transistortypen** → **NMOS-** und **PMOS-Transistoren**
- **In der Abbildung:** NMOS oben links, PMOS oben rechts
- In der CMOS-Technologie werden beide Typen in jeweils komplementären Netzen eingesetzt



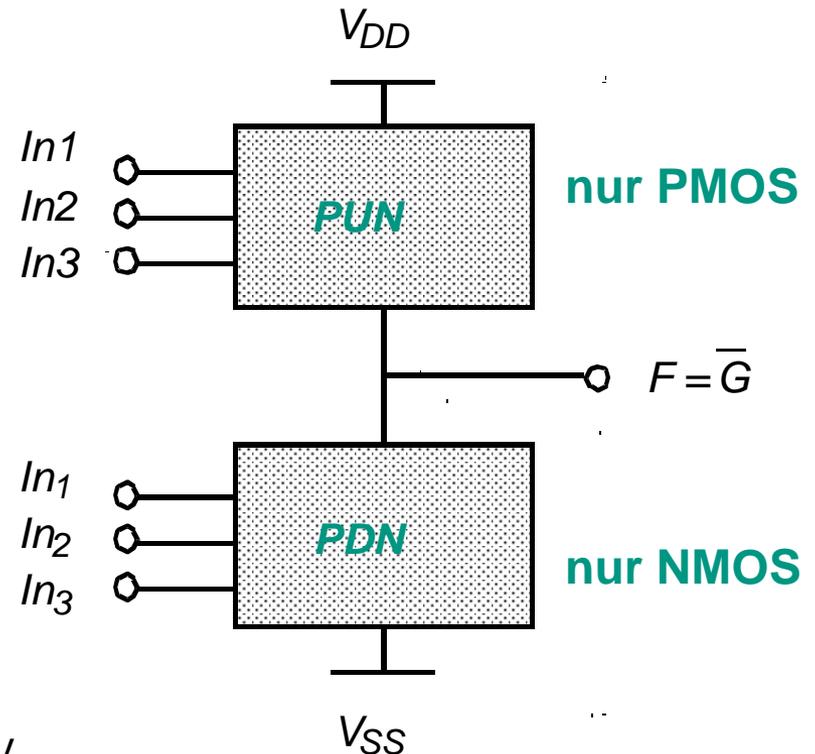
NMOS



PMOS

PUN und PDN -> duale (komplementäre) Netze:

- Die **CMOS-Technologie** basiert auf **komplementären Netzen**
→ **PUN** und **PDN**
(**P**ull-**U**p/**P**ull-**D**own **N**etz)
- Ist der **Ausgang** der realisierten Funktion gleich **1**, schaltet das **PUN-Netz** den **Ausgang F** auf V_{DD}
- Ist der **Ausgang** hingegen gleich **0**, schaltet das **PDN-Netz** den **Ausgang F** auf V_{SS}
- Zur Realisierung der **PUN-Netze** werden **PMOS-Transistoren** eingesetzt, **PDN-Netze** werden mit **NMOS-Transistoren** implementiert
- Da außer zu Schaltzeitpunkten keine direkte Verbindung zwischen V_{DD} und V_{SS} besteht, wird **während des Haltens sehr wenig Energie verbraucht**



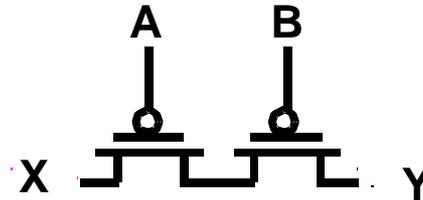
Transistoren → Schalterrealisierung

→ Steuerung durch Gate-Signal

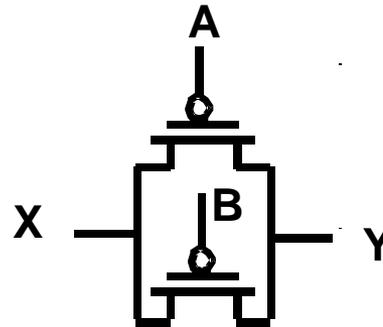
NMOS-Schalter schließt, wenn das Gate auf “high” (H, “1”) ist



PMOS-Schalter schließt, wenn das Gate auf “low“ (L, “0“) ist



$$Y = \overline{A} \text{ AND } \overline{B} = \overline{A + B}$$



$$Y = \overline{A} \text{ OR } \overline{B} = \overline{AB}$$

NMOS-, PMOS-Schaltungen: Anbindung an Axiome der Schaltalgebra

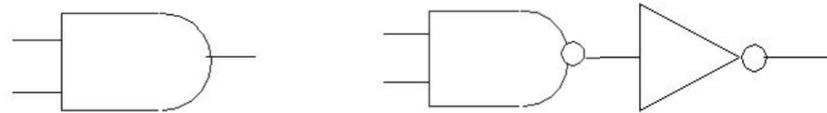
→ Realisierung der Konjunktion, Disjunktion und Negation

PUN ist zu *PDN* dual (\rightarrow komplementär)
(kann mittels DeMorgan`s Theorem gezeigt werden)

$$\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$$

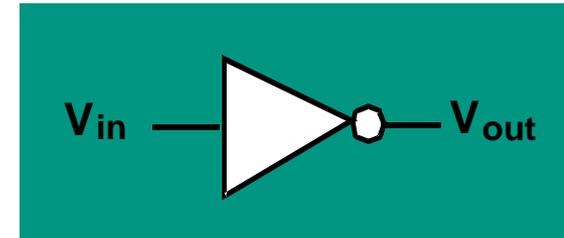
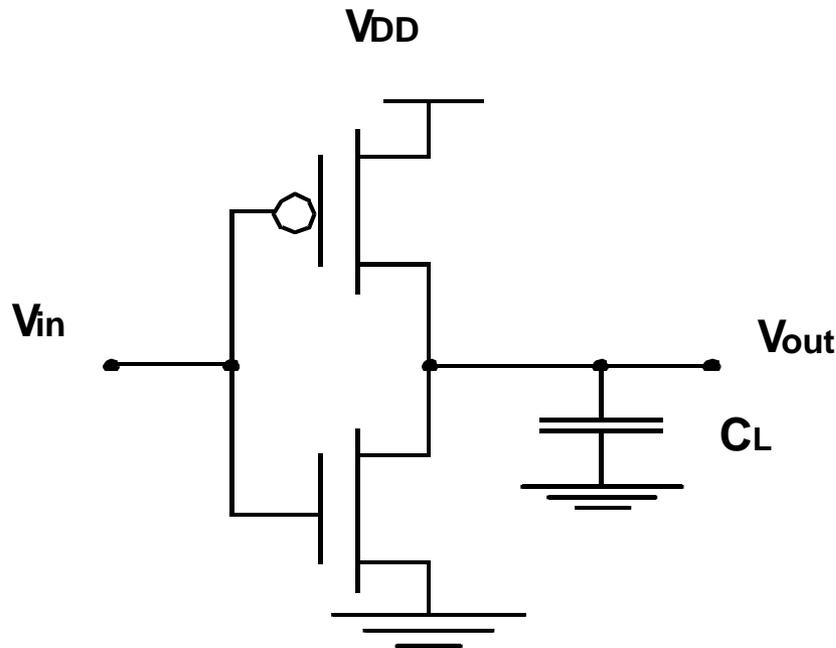
$$\overline{A B} = \overline{A} + \overline{B}$$

Das komplementäre Gatter ist invertierend



AND = NAND + INV

CMOS: *Inverter*-Schaltung

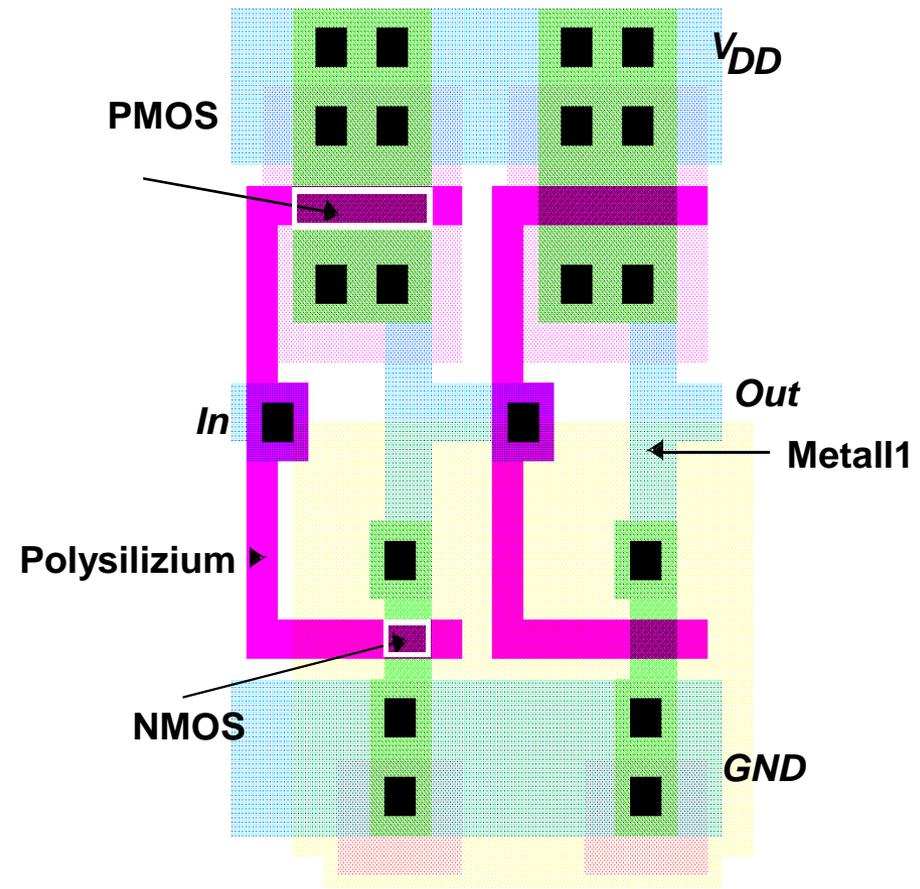


- Der *Inverter* besteht aus **zwei Transistoren**, einem NMOS und einem PMOS
- Ist V_{in} auf **high**, so **öffnet** der **NMOS-Transistor** und V_{out} wird auf **GND** gezogen, während dessen ist der **PMOS-Transistor gesperrt**
- Ist V_{in} hingegen auf **low**, so **öffnet** der **PMOS-Transistor** und V_{out} wird auf **V_{DD}** gezogen, der **NMOS-Transistor** wird hingegen **gesperrt**
- Strom zwischen V_{DD} und GND kann nur fließen, wenn die Transistoren umschalten und kurzzeitig beide offen sind

CMOS: *Inverter-Layout*

- Das **Layout** stellt zwei in Serie geschaltete Inverter dar
- Das **Polysilizium** wird genutzt, um die **Gates** auf dem Silizium zu realisieren
- Das **rote Gebiet** oben ist die **n-Wanne** für die PMOS-Transistoren
- Die **blauen Felder** sind **Metalleiter**, wo meist Aluminium oder in moderneren Verfahren Kupfer zum Einsatz kommt
- Die **grünen Gebiete** sind **Diffusionsgebiete**, und mit **schwarzen Vierecken** stellen diese **Kontaktierungen** zwischen den **Source-** bzw. **Drain-Gebieten** und den **Metalleitern** dar

CMOS-Maskenlayout

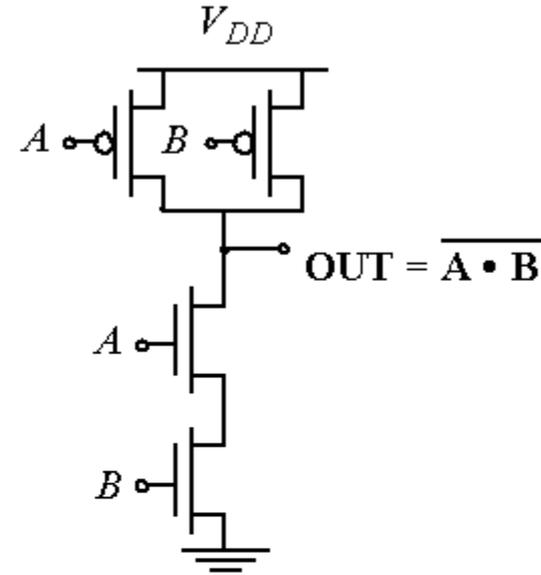


CMOS-Beispielgatter: *NAND*

CMOS-Schaltung für *NAND*

A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Truth Table of a 2 input *NAND* gate



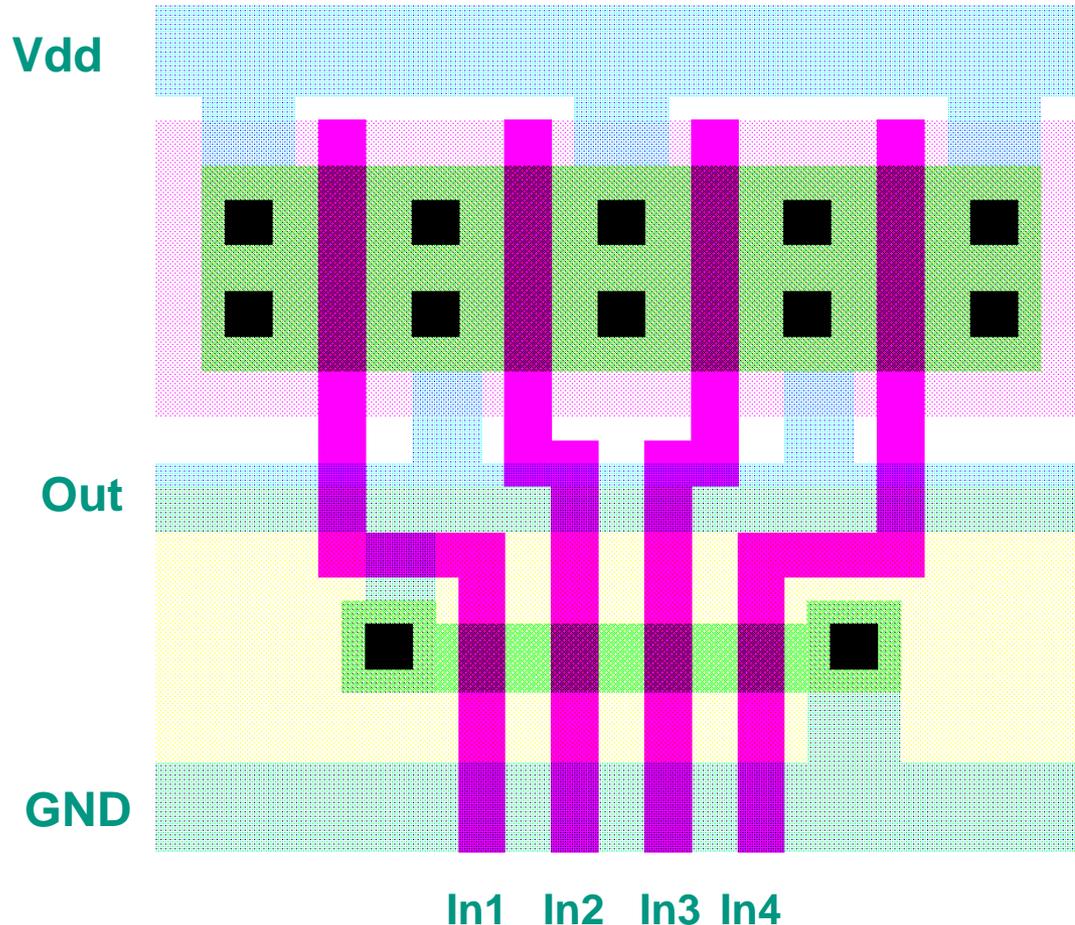
PDN: $G = A B \Rightarrow$ Conduction to GND

PUN: $F = \overline{A + B} = \overline{A} \overline{B} \Rightarrow$ Conduction to V_{DD}

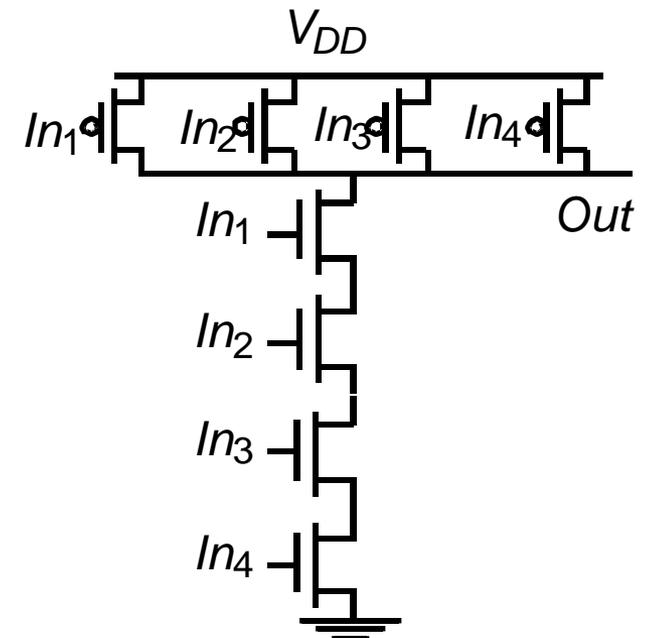
$$\overline{G(In_1, In_2, In_3, \dots)} \equiv F(\overline{In_1}, \overline{In_2}, \overline{In_3}, \dots)$$

CMOS: *NAND*-Gatter mit 4 Eingängen

CMOS-Maskenlayout



CMOS-Schaltung für *NAND*-4

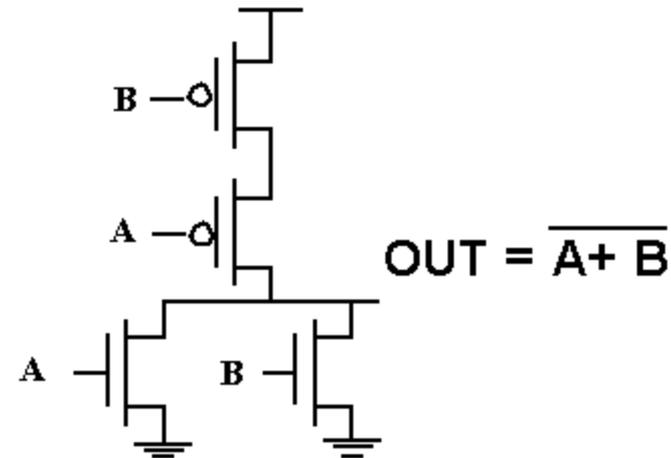


CMOS-Beispielgatter: *NOR*

CMOS-Schaltung für *NOR*

A	B	Out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

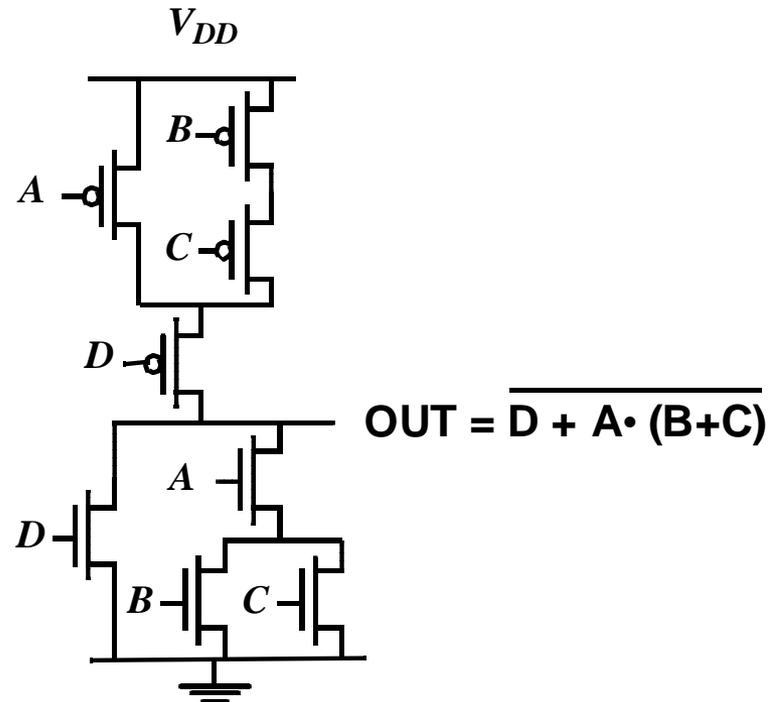
Truth Table of a 2 input NOR gate



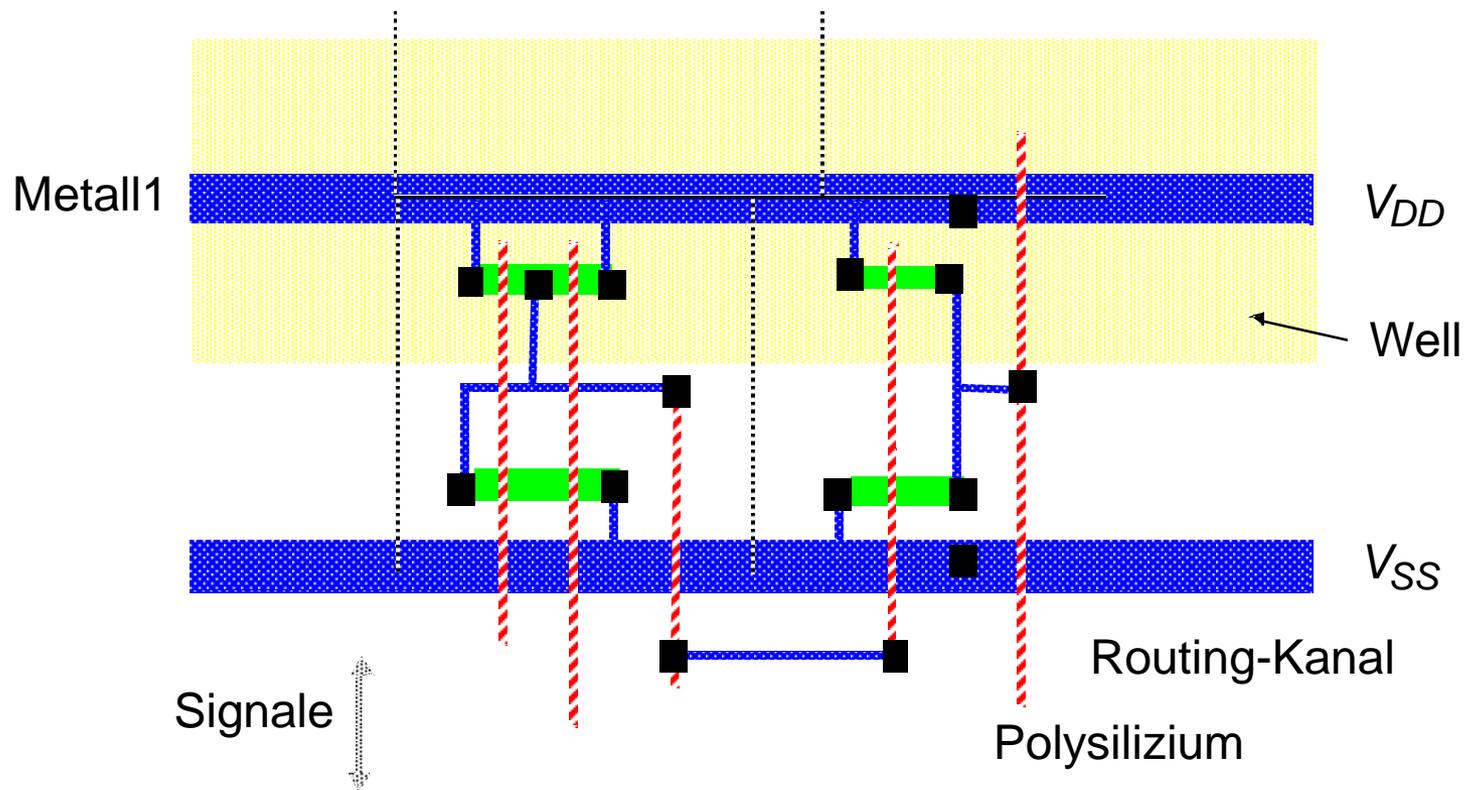
PUN- und PDN-Netzentwurf (Funktionen G und F zur Übung!)

CMOS-Beispielgatter: *komplexes Gatter*

CMOS-Schaltung für *komplexes Gatter*



- In der **CMOS-Technik** lassen sich ebenfalls **komplexere Gatter** modellieren (siehe Schaltung oben)
- Dies muss jedoch durch entsprechende **Dimensionierung** der **W** (Transistor-Kanalbreite) und **L** (Kanallänge) **Größen** der Transistoren geschehen, damit die geforderte Symmetrie wie beim Inverter erhalten bleibt



- Das oben dargestellte **Standardzellenlayout** realisiert die Funktion: $y = \overline{a \& b} = a \& \overline{b}$
- Die **Standardzellen-Methodik** beinhaltet nur **Basiszellen gleicher Höhe**
-> oben V_{DD}- und unten V_{SS}-Leitungen: in den Zwischenräumen werden die gewünschten Schaltglieder (*Gatter*) modelliert

Heutiger Rechnergestützter Entwurf

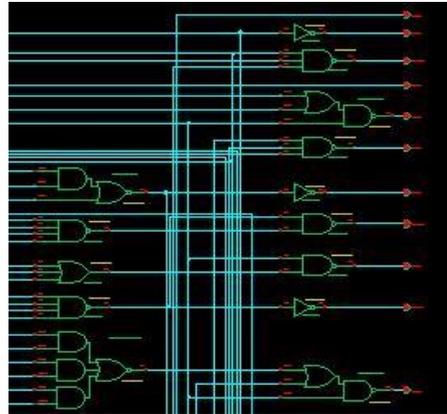
Hardware Beschreibung

```
architecture structural of first_tap is
signal x_q,red : std_logic_vector(bitwidth-1
downto 0);
signal mult : std_logic_vector(2*bitwidth-1
downto 0);
begin
delay_register:
process(reset,clk)
begin
if reset='1' then
x_q <= (others => '0');
elsif (clk'event and clk='1') then
x_q <= x_in;
end if;
end process;
mult <= signed(coef)*signed(x_q);
```

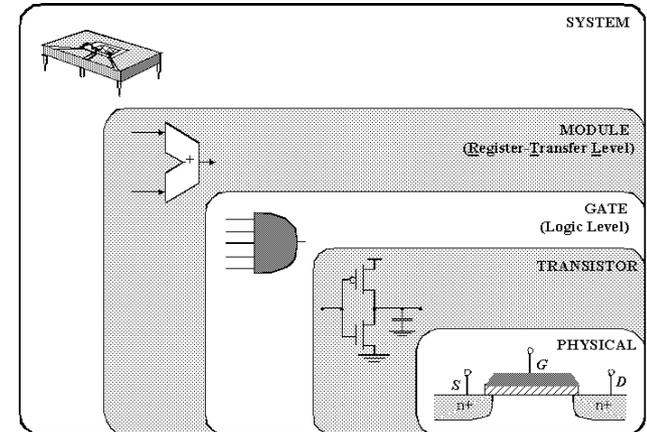


Synthese
(Synopsys)

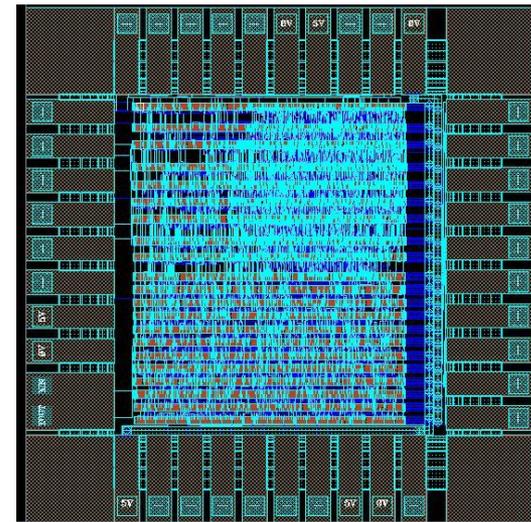
Netzliste



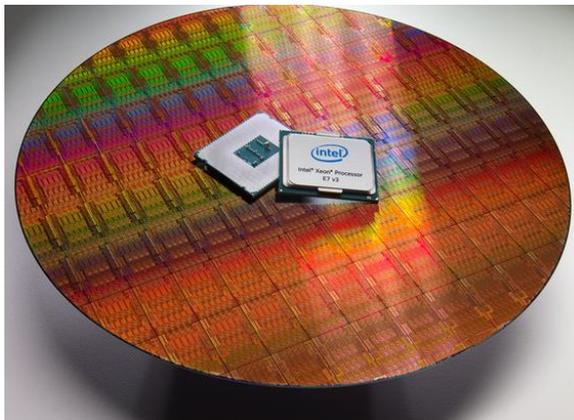
Abstraktionsebenen



Platzierung & Verdrahtung
(Cadence/
Mentor)



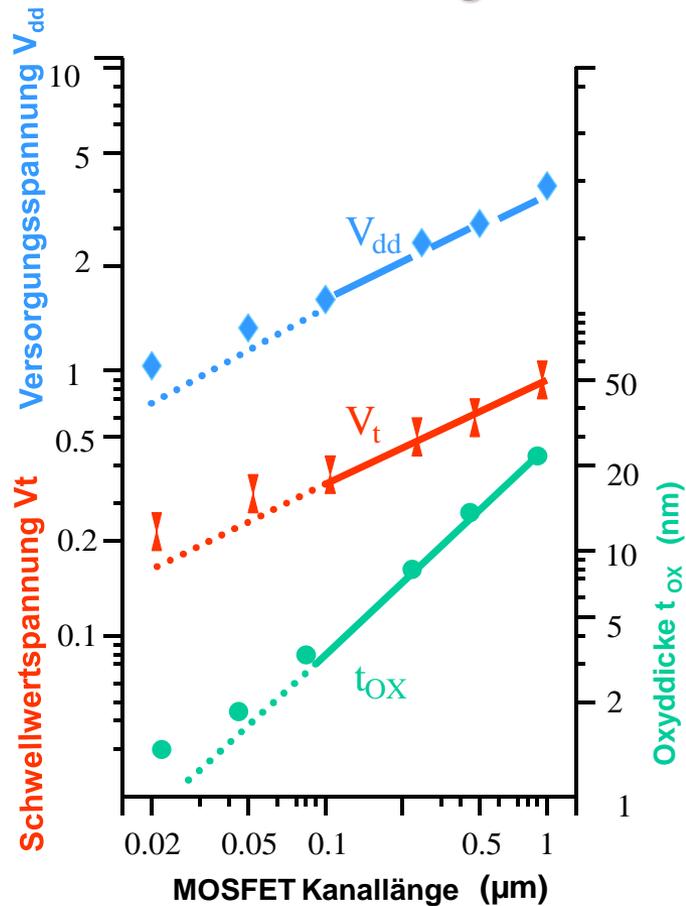
Fabrikation



Chip Wafer

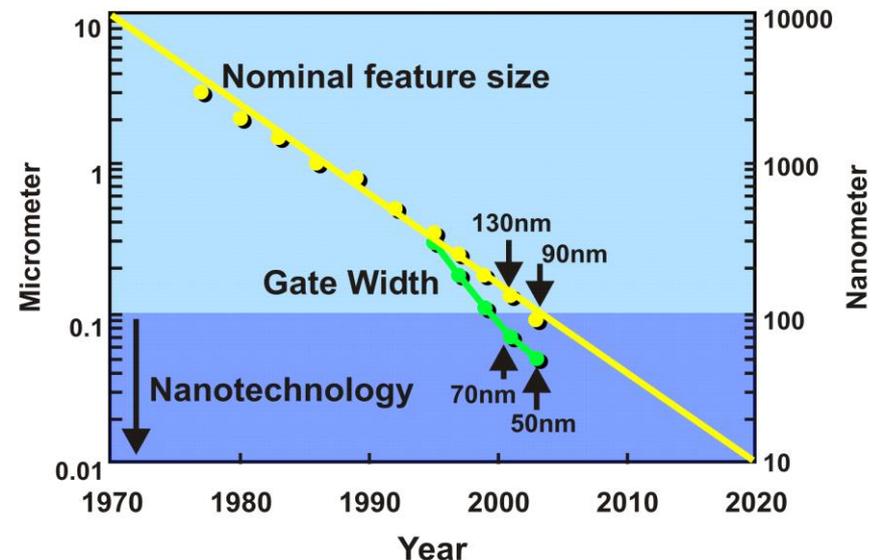
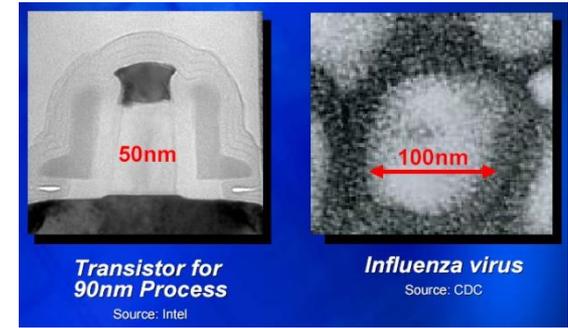
Masken-
Layout

Schnelle Evolution der IC-Technologien



Quelle: Intel Technology Roadmap for Semiconductors ITRS

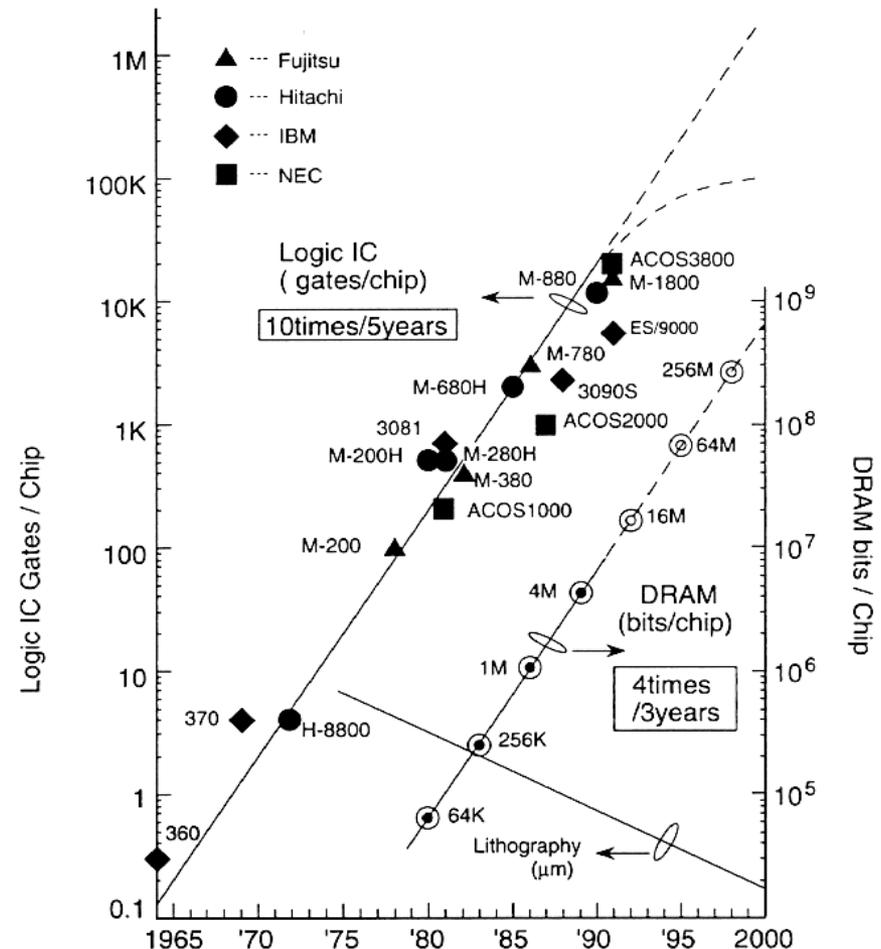
CMOS-Skalierung



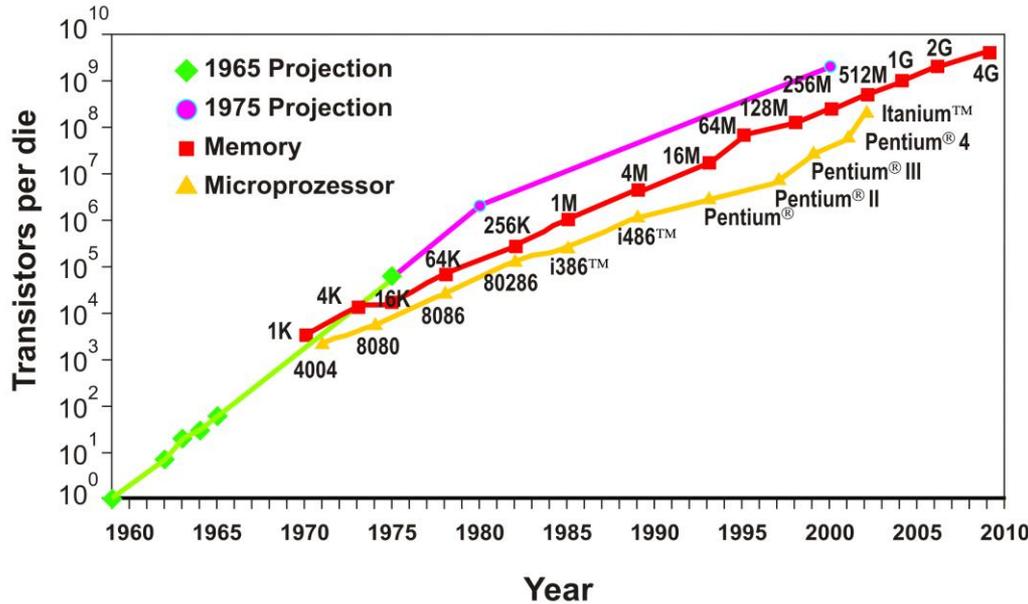
Digitalentwurf am Scheideweg ?

Moore's Gesetz

- Die Komplexität von Speicherchips und Mikroprozessoren wuchs exponentiell
- Es war genau diese Abbildung, die Moore vorhersagte
- Moore's Law:** Integrationsdichte verdoppelt sich alle 18 Monate



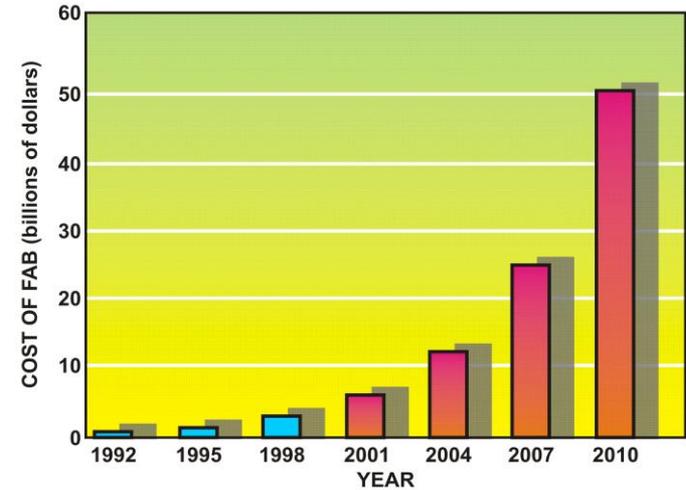
Prozessor- und Speicherintegration



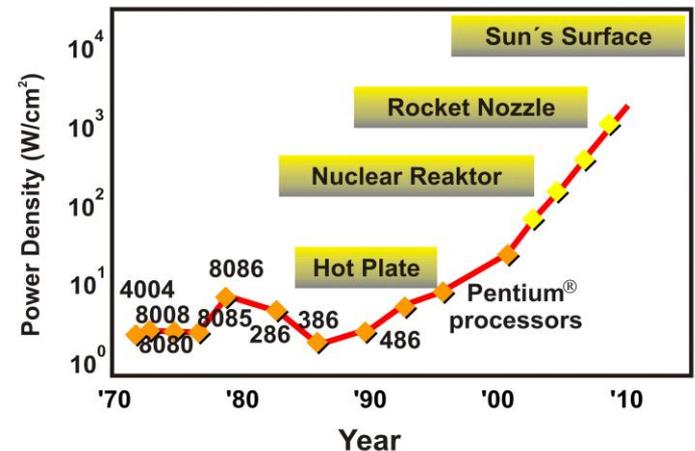
Prozessor- und Speicherintegrationsdichten im Vergleich zu Moore's Gesetz

(Quelle: International Technology Roadmap for Semiconductors ITRS)

Kostenentwicklung

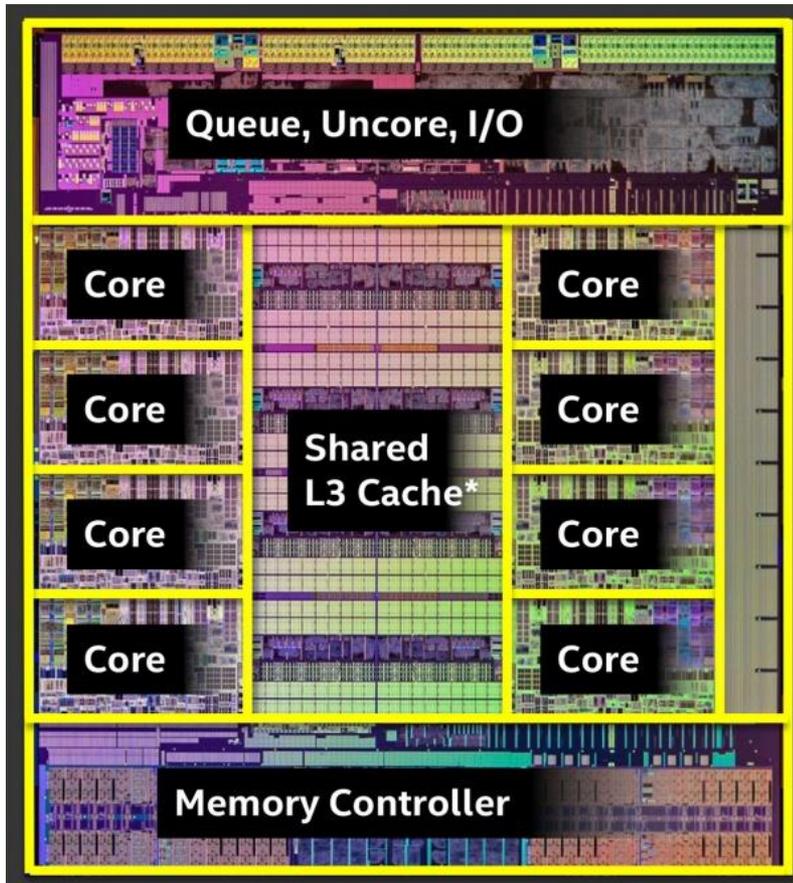


Verlustleistungsentwicklung



Intel's Prozessorlösung: Core i7

22 nm Intel Core i7-5960X



- 8 Cores, 16 Threads
- 3.2 Milliarden Transistoren
- 355 mm² Die-Size
- 20 MB On-Chip L3-Cache
- 3.5 GHz Turbo Boost

Quelle: Jason Stinson (Intel), 2014